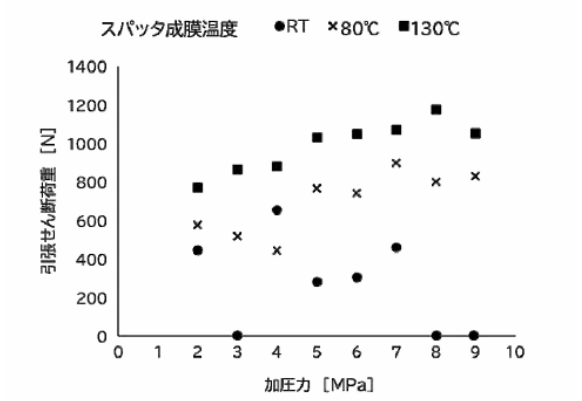
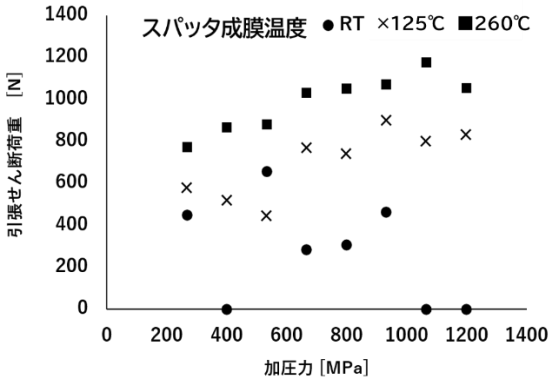
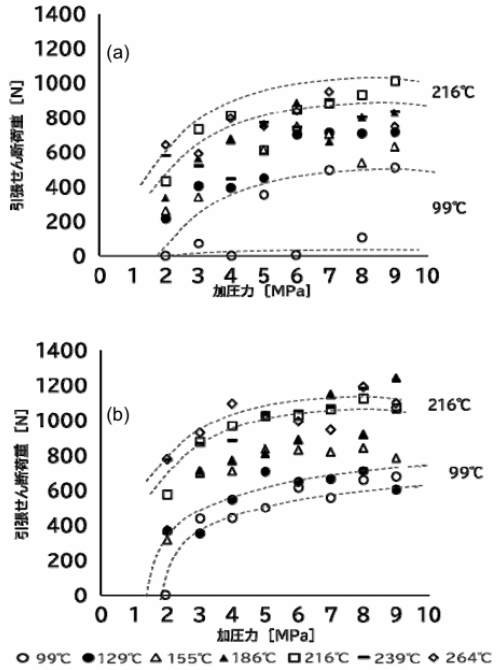
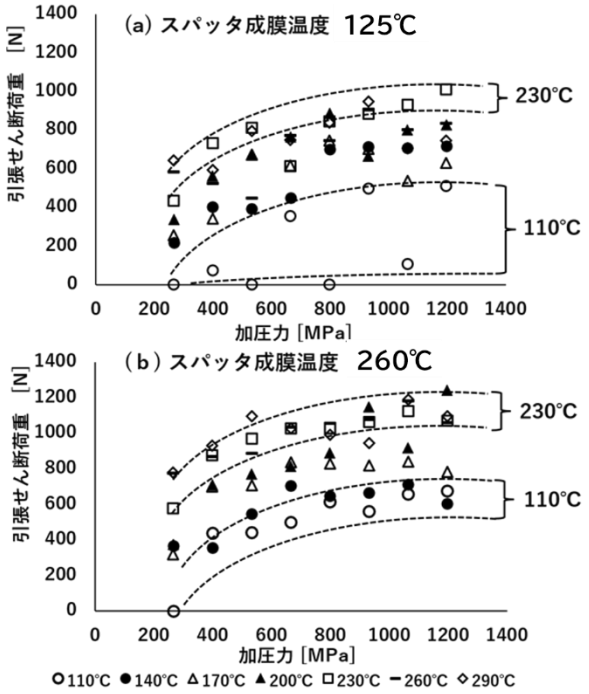
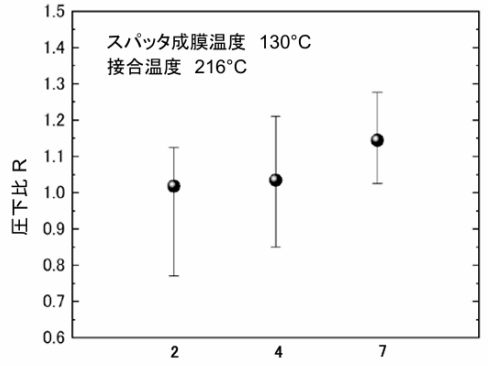
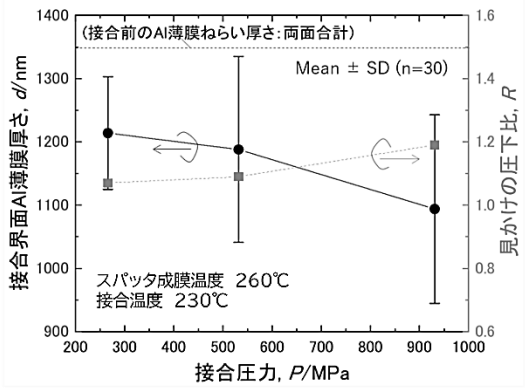
令和７年度（第 38 回）若い研究者を育てる会の研究論文集「Ⅳ．薄膜における接合技術に関する研究」におきまして、以下のとおり誤りがありました。
謹んでお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正申し上げます。

訂正論文：令和７年度（第 38 回）若い研究者を育てる会 研究発表会 研究論文集 p21-26

	誤	正
22 頁右段 10 行	99℃～264℃の間で、加圧力は 2~9 MPa の間で	110℃～290℃の間で、加圧力は 266~1197MPa の間で
23 頁左 12 行	スパッタ成膜温度を室温（RT）、80℃、130℃と変化させて	スパッタ成膜温度を室温（RT）、125℃、260℃と変化させて
23 頁右図 5	図５　各成膜温度におけるスパッタ膜表面の SEM 像(a)RT,(b)80℃,(c)130℃ Fig.5 SEM images of sputterd film surfaces at each deposition temperature (a)RT,(b)80℃,(c)130℃	図５　各成膜温度におけるスパッタ膜表面の SEM 像(a)RT,(b)125℃,(c)260℃ Fig.5 SEM images of sputterd film surfaces at each deposition temperature(a)RT,(b)125℃,(c)260℃
23 頁右図 6	 図 6 各成膜温度における引張せん断強度 Fig. 6 Bonding strength at each film deposition temperature	 図 6 各成膜温度における引張せん断強度 Fig. 6 Bonding strength at each film deposition temperature
24 頁左段 1 行	各スパッタ成膜温度（RT,80℃130℃）で、接合温度 239℃	各スパッタ成膜温度（RT,125℃260℃）で、接合温度 260℃
24 頁左段 7 行	スパッタ成膜温度 80℃、130℃においては、すべての試料において接合に成功し、加圧力が大きくなるほど引張せん断強度が上がる傾向が確認された。また、80℃よりも、130℃方が引張せん断強度は強かった。これは、成膜後の膜表面に形成された凹凸が、130℃の方が大きく、	スパッタ成膜温度 125℃、260℃においては、すべての試料において接合に成功し、加圧力が大きくなるほど引張せん断強度が上がる傾向が確認された。また、125℃よりも、260℃の方が引張せん断強度は強かった。これは、成膜後の膜表面に形成された凹凸が、260℃の方が大きく、

24 頁 図 7	 図 7　各接合温度における引張せん断強度 (a)スパッタ成膜温度 80°C (b)スパッタ成膜温度　130°C Fig. 7　Bonding strength at each jointing temperature (a)film formation temperature 80°C, (b)film formation temperature 130°C	 図7　各接合温度における引張せん断強度 (a)スパッタ成膜温度 125℃ (b)スパッタ成膜温度　260℃ Fig. 7　Bonding strength at each jointing temperature (a)film formation temperature 125℃, (b)film formation temperature 260℃
24 頁左 段 14 行	スパッタ成膜温度 80℃、130℃で成膜した試料について、接合温度を 99-264°C(実測値)の範囲、また加圧力は 2-9 MPa の範囲で変化	スパッタ成膜温度 125℃、260℃で成膜した試料について、接合温度を 110℃～290℃の範囲、また加圧力は 266~1197MPa の範囲で変化
24 頁左 段 18 行	スパッタ成膜温度 80℃においては、接合温度 99°C では	スパッタ成膜温度 125℃においては、接合温度 110°C では
24 頁右 段 6 行	スパッタ成膜温度 130°C においては、接合温度 99°C と低い接合温度においても、接合できない試験片は、加圧力の低い 2MPa で加圧した試料のみとなり、3 MPa～9 MPa で接合	スパッタ成膜温度 260°C においては、接合温度 110°C と低い接合温度においても、接合できない試験片は、加圧力の低い 266MPa で加圧した試料のみとなり、399~1197MPa で接合
24 頁右 段 11 行	スパッタ成膜温度 80°C	スパッタ成膜温度 125°C
24 頁右 段 14 行	スパッタ成膜温度 80°C に比べ、130°C の方が	スパッタ成膜温度 125°C に比べ、260°C の方が
24 頁 図 8	図 8　圧力における接合した試料の Al-Al 界面の断面 FE-SEM 像 (a)2MPa, (b)4MPa, (c)7MPa Fig. 8 FE-SEM image of the Al-Al interface in the sample (a)2MPa, (b)4MPa, (c)7MPa	図 8　各圧力における接合した試料の Al-Al 界面の断面 FE-SEM 像 (a)266MPa, (b)532MPa, (c)931MPa Fig. 8 FE-SEM image of the Al-Al interface in the sample (a)266MPa, (b)532MPa, (c)931MPa
24 頁右 段 19 行	スパッタ成膜温度 80°C、130°C の	スパッタ成膜温度 125°C、260°C の
25 頁左 段 1 行	接合温度 216°C 程度で頭打ちとなる挙動が確認された。	接合温度 230°C 程度で頭打ちとなる挙動が確認された。

25 頁左段 4 行	接合温度 186℃、 加圧力 9 MPa において	接合温度 200℃、 加圧力 1197MPa において
25 頁左段 11 行	スパッタ成膜温度 130℃、接合温度 216℃、加圧力 2 MPa、4 MPa、7 MPa で接合した試料の Al/Al 界面の FE-SEM 像を示す。加圧力 2 MPa, 4 MPa においては、Al/Al 界面にボイドが確認される個所もあり、膜面全体において均一な接合をしていないことが確認された。7 MPa においては、	スパッタ成膜温度 260℃、接合温度 230℃、加圧力 266 MPa、532 MPa、931 MPa で接合した試料の Al/Al 界面の FE-SEM 像を示す。加圧力 266MPa, 532MPa においては、Al/Al 界面にボイドが確認される個所もあり、膜面全体において均一な接合をしていないことが確認された。931MPa においては、
25 頁図 9	 図 9 加圧力に対する Al 薄膜の圧下比 Fig. 9 Pressure dependence of the apparent reduction of Al thin films	 図 9 接合圧力に対するAl薄膜の圧下比 Fig.9 Pressure dependence of the apparent reduction of Al thin films
25 頁左段 29 行	圧下比は 7 MPa の圧力で加圧した際でも 1.14 程度と低い	圧下比は 931MPa の圧力で加圧した際でも 1.2 程度と低い
25 頁右段 4 行	スパッタ成膜温度 130℃、接合温度 216℃、加圧力 7 MPa	スパッタ成膜温度 260℃、接合温度 230℃、加圧力 931 MPa
25 頁右段 10 行	接合温度 216℃ 程度で	接合温度 230℃ 程度で
26 頁左段 1 行	スパッタ成膜温度 80℃、130℃ においては、成膜後の膜表面に形成された凹凸がより大きくなることで、ばらつきは小さくなり、安定的な接合が可能であることが分かった。また、80℃ よりも、130℃ 方が引張せん断強度は強かった。また、スパッタ成膜温度 80℃、130℃ における接合温度を変化させて行った接合強度の評価では、スパッタ成膜温度 80℃、130℃ の	スパッタ成膜温度 125℃、260℃ においては、成膜後の膜表面に形成された凹凸がより大きくなることで、ばらつきは小さくなり、安定的な接合が可能であることが分かった。また、125℃ よりも、260℃ 方が引張せん断強度は強かった。また、スパッタ成膜温度 125℃、260℃ における接合温度を変化させて行った接合強度の評価では、スパッタ成膜温度 125℃、260℃ の
26 頁左段 11 行	7 MPa の加圧力において、Al/Al 界面にボイドの存在しない均一な界面を形成していることが分かった。圧下比の評価では、加圧力を大きくするに従い、圧下比は大きくなった。Al 展伸材同士の低温鍛 接では、圧下比 1.4 程度(3)であるが、マイクロ低温鍛接における接合では 7 MPa の圧力でも 1.14 程度と低い	931 MPa の加圧力において、Al/Al 界面にボイドの存在しない均一な界面を形成していることが分かった。圧下比の評価では、加圧力を大きくするに従い、圧下比は大きくなった。Al 展伸材同士の低温鍛接では、圧下比 1.4 程度(3)であるが、マイクロ低温鍛接における接合では 931MPa の圧力でも 1.2 程度と低い